



PRESSEMITTEILUNG

Veröffentlichung vom Dezember 2023, Wireless

Wireless Design-In

Kompakte Multiprotokoll-Konnektivität für IoT-Anwendungen

Der Value Added Distributor und Lösungsanbieter HY-LINE Technology GmbH erweitert sein Produktportfolio um die Wireless-Module MGM210P und BGM240P. Das Support-Team unterstützt Kunden umfassend bei der Integration dieser Module in ihre Applikation.

Mit dem MGM210P lassen sich platzsparende IoT-Designs für intelligente Beleuchtungs-, HVAC, Gebäude- und Fabrikautomatisierungssysteme und Ähnliches realisieren. Unterstützt werden Bluetooth 5.1, Bluetooth Mesh, Thread, Zigbee und Multi-Protokoll-Anwendung mit Zigbee. Eine Variante verfügt über eine integrierte Chipantenne, die andere über einen Pin zum Anschluss einer externen Antenne.

Auf dem kompakten Board befindet sich alles, was für ein leistungsfähiges IoT-Wireless-Modul benötigt wird: Das System-On-Chip (SoC) EFR32MG21 verfügt über einen 32-Bit Cortex M33 Core, 1024/96 kB Flash/RAM, Security Core für Verschlüsselung, Transceiver, Timer, Analog-Digital-Wandler (ADC), I/O-Ports, serielle Schnittstelle und Power-Management-Funktion.

Das neue Bluetooth-5.3-Modul BGM240P ermöglicht Bluetooth Low Energy-Konnektivität, bietet eine außergewöhnliche RF-Leistung und Energieeffizienz sowie einen hohen Schutz gegen Hacker-Angriffe und Manipulationen. Das kompakte Board ist mit dem SoC EFR32BG24 ausgestattet, das über einen 32-Bit ARM Cortex-M33 Core, 1.536 kB Flash-Speicher, 256 kB RAM, Security Core für Verschlüsselung, Power-Management-Funktionen, Timer, Analog-Digital-Wandler (ADC) und serielle I/O verfügt. Die Basis der Secure-Vault-Funktionen bildet der Security Core, der kryptographische Funktionen und Daten vom Cortex-M33-Core isoliert.

hy-line-group.com

Mit dieser Architektur wird eine sichere und hocheffiziente Bluetooth-Mesh-Konnektivität ermöglicht. Der robuste Software-Stack verfügt über weltweite behördliche Zertifizierungen.

Die Wireless-Module MGM210P und BGM240P benötigen wenig Platz (12,9 x 15,0 mm) und werden mit integrierter Antenne oder mit RF-Pin zum Anschluss einer externen Antenne angeboten.

Mehr erfahren

Wireless-Module von SILICON LABS -> [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

((Shortcut Link bitte liefern))

Pressebild



A10789-03_SILICON_LABS.jpg

Bildunterschrift:

Die Wireless-Module MGM210P und BGM240P ermöglichen kompakte drahtlose IoT-Designs im 2,4-GHz-Frequenzbereich



SEO

Wireless Design-In, Wireless-Module, Modul für IoT-Konnektivität, Modul für Bluetooth 5.1, Funkmodul mit Security Core, Secure-Vault-Funktionen, Konnektivitätsmanagement, Energy-Management-Funktion, Software-Stack mit behördlichen Zertifizierungen, Konnektivität für Beleuchtungssysteme, Module für HVAC-Funklösung, Funktechnik für Gebäudeautomatisierung, Wireless Konnektivität für Fabrikautomatisierung

HY-LINE Technology GmbH
Inselkammerstr. 10
82008 Unterhaching
E-Mail: sales@hy-line.de
Tel.: +49 89 614 503 10